

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2253号）。《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<http://www.cs.com.cn>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股票数量为 66,206,036 股，占发行后总股本的比例为 10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形
本次发行价格（元/股）	22.66
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员和核心员工通过中信证券资管上海合晶员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划、中信证券资管上海合晶员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参与战略配售

	数量为 3,081,199 股，占本次公开发行股份数量的 4.65%，获配金额 6,982.00 万元。前述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为本次公开发行股份数量的 4.00%，即 2,647,837 股，获配金额 6,000.00 万元。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
发行前每股收益	0.60 元（以 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	0.54 元（以 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	42.05 倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行市净率	3.70 倍（按发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	4.47 元（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	6.12 元（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	150,022.88
发行费用（不含税）	本次发行费用明细（不含增值税）如下： 1、保荐费用：188.68 万元； 2、承销费用：8,538.05 万元； 3、审计、验资费用：875.47 万元； 4、律师费用：870 万元； 5、用于本次发行的信息披露费用：452.83 万元； 6、发行手续及其他费用：80.34 万元。
发行人和保荐人、主承销商及联席主承销商	

发行人	上海合晶硅材料股份有限公司		
联系人	庄子祊	联系电话	021-57843535-5829
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-60833640
联席主承销商	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620563

发行人：上海合晶硅材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2024年2月5日

（此页无正文，为《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页）



发行人：上海合晶硅材料股份有限公司

2024年2月5日

(此页无正文，为《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页)

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



2024年2月5日

（此页无正文，为《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

